

5月市场洞察报告

半导体市场分析与趋势展望

洞察行情 精准决策

“DISTINCTIVE
INSIGHTS,
INFORMED
DECISION-MAKING”

序言

本报告由安芯易电子商务（深圳）有限公司推出，旨在为客户、供应商及合作伙伴提供半导体行业资讯及市场趋势预测，报告涵盖宏观动态、半导体产业动态、终端市场动态、重点产品行情等模块，助力行情洞察、精准决策。

本报告每月更新，可关注安芯易电子订阅号，及时获取报告发布等信息。您可以通过联系安芯易客户经理获取完整版报告。

目录

摘要..... 4

一、 宏观动态..... 5

 (一) 行业政策..... 5

 (二) 经济指数..... 7

二、 半导体产业动态..... 11

 (一) 短期影响..... 12

 (二) 中期影响..... 12

 (三) 长期影响..... 13

三、 终端市场动态..... 15

 (一) 人工智能..... 15

 (二) 新能源..... 16

 (三) 消费电子..... 16

 (四) 工业电子..... 16

 (五) 汽车电子..... 17

 (六) 通信电子..... 17

 (七) 医疗电子..... 17

四、 重点产品行情..... 18

 (一) 存储芯片..... 18

 (二) GPU..... 19

 (三) MCU..... 20

信息来源..... 21

免责声明..... 22

摘要

2025 年 5 月重点行情趋势	
宏观动态	● 中美日内瓦经贸会谈联合声明，暂停关税战！ ● 欧盟通过《芯片法案》修正案，全球半导体产业政策竞赛白热化 ● 国家发改委缩减市场准入负面清单至 106 项，降低准入门槛激发创新活力 ● 中国半导体行业协会发布关于半导体产品“原产地”认定规则的紧急通知 ● 韩国通过 2000 亿韩元 AI 基金和 5000 亿韩元半导体专项
产业动态	● 英伟达推动本土 AI 算力部署, Blackwell 芯片美产加速; 存储价格反弹, DDR4 退场与 HBM/LPDDR5X 加速切换; 圣邦微电子一季度营收同比增长 8.3%, 达 7.9 亿元 ● 英特尔委托台积电代工 2nm, IDM 战略面临现实调整; 意法半导体推出新一代车规级 MCU, 强化汽车电子市场布局; 安世半导体推出 1200V SiC MOSFET, 拓展汽车与工业应用; 兆易创新与纳微半导体达成战略合作, 打造高效数字电源解决方案 ● 高通加大自研 AI 芯片投入, 布局边缘计算和智能终端市场; 三星加速 HBM4 研发, 布局 AI 高带宽内存市场; 士兰微中国 28nm 以上成熟制程 IDM 扩产
终端市场	● 人工智能: 英伟达与沙特 HUMAIN 合作建设 AI 工厂, 将部署 1.8 万块 GPU 构建 500 兆瓦算力中心; DeepSeek 发布 Prover-V2 模型, 参数量达 6710 亿 ● 新能源: 宁德时代发布全球首款 9MWh 储能系统; 特斯拉 Q1 交付量跌至三年来最低水平 ● 消费电子: 华为 Pura80 系列将搭载麒麟 9020 芯片和定制 RYYB 传感器; 优必选与创耀科技合作开发人形机器人芯片解决方案, 瞄准机器人自动化应用场景 ● 工业电子: 霍尼韦尔预计今年销售额为 396-405 亿美元 ● 汽车电子: 德赛西威德国工厂已生产运营, 西班牙工厂预计年底竣工 ● 通信电子: 中兴通讯 2025Q1 智算服务器订货占比超 60% ● 医疗电子: 强生加码手术机器人、AI 医疗等高附加值领域; 预计下半年营收增长会更高
产品行情	● 存储芯片: 五大 NAND 原厂同步减产, 部分产品价格上涨 ● GPU: 英伟达 GPU 市场份额下滑, AMD、英特尔份额上涨 ● MCU: MCU 车规市场规模可观, 国产替代化加速

一、宏观动态

（一）行业政策

● 中美日内瓦经贸会谈联合声明，暂停关税战！

5月12日，中美在瑞士日内瓦举行经贸高层会谈，双方发布《中美日内瓦经贸会谈联合声明》，宣布暂停部分对等关税90天，并达成多项共识。中美经贸会谈联合声明，强调双边经贸关系对全球经济的战略意义，重申构建可持续、互利经贸关系的重要性。

1) 谈判背景

4月2日，美国总统特朗普在白宫签署“对等关税”行政令，宣布对贸易伙伴加征10%“最低基准关税”，部分贸易伙伴关税更高，如中国达34%、越南46%、泰国36%、印度尼西亚32%、印度26%、日本24%、韩国25%，欧盟国家升至20%。10%关税4月5日凌晨生效，更高关税4月9日生效。中国迅速反击，国务院关税税则委员会发布公告，经国务院批准，自4月10日12时01分起，对原产于美国的进口商品加征34%关税。4月10日，美国又将中国输美商品“对等关税”税率提至125%。4月12日，中国国务院关税税则委员会发布公告，将加征美国关税税率由84%调高至125%。

2) 谈判结果

根据《联合声明》，中美双方承诺于5月14日前实施以下措施：

- 1) 美方将14257号行政令中对华商品24%的关税（含港澳地区）在初始的90天内暂停实施，保留10%关税，同时撤销14259号及14266号行政令加征关税；
- 2) 中方将同步调整税委会2025年第4号公告对美商品24%的关税在初始的90天内暂停实施并保留10%关税，取消第5、6号公告加征关税。

3) 未来预期

随着日内瓦经贸会谈联合声明的发布，中美关税战迎来重要转折点，主要经济体就削减非关税壁垒达成阶段性共识，为重构多边贸易框架奠定制度性基础。中国商务部对会谈结果表示高度肯定，称：“此举符合生产者和消费者的预期，符合两国利益和全球共同利益。”国务院副总理何立峰在11日晚的新闻发布会上进一步指出：“会谈富有成效，超出了我们此前的预期，迈出了通过平等对话协商解决分歧的重要一步，为进一步弥合分歧和深化合作打下了基础、创造了条件。”

- **欧盟启动《芯片法案》修正案，全球半导体产业政策竞赛白热化**

5月2日，欧盟开启了《芯片法案》修正案，预计追加150亿欧元攻关2纳米以下先进制程和第三代半导体材料与AI芯片架构。据悉，欧盟在2022年底推出了《芯片法案》，明确提出到2030年将欧盟在全球半导体市场的份额从10%提升至20%，并实现2纳米及以下先进制程的本土生产。为此，法案计划调动430亿欧元公共与私人投资。此次修正案与旧版法案相比，将更加注重发挥欧盟现有的战略优势，而非盲目追求市场份额的提升。

- **国家发改委缩减市场准入负面清单至106项，降低准入门槛激发创新活力**

据国家发展改革委网站4月24日消息，近日，经党中央、国务院批准，国家发展改革委同商务部、市场监管总局发布《市场准入负面清单（2025年版）》（以下简称《清单（2025年版）》），清单事项数量由2022年版的117项缩减至106项，市场准入限制进一步放宽，市场准入管理更加优化，市场准入制度建设取得新的重要成果。

- **中国半导体行业协会发布关于半导体产品“原产地”认定规则的紧急通知**

4月11日，中国半导体行业协会发布关于半导体产品“原产地”认定规则的紧急通知，根据海关总署的相关规定，“集成电路”原产地按照四位税则号改变原则认定，即流片地认定为原产地。“集成电路”无论已封装或未封装，进口报关时的原产地以“晶圆流片工厂”所在地为准进行申报。此项政策将压缩部分“伪国产”芯片通过境外生产再回流国内市场的空间，有利于推动国产替代。

- **韩国通过2000亿韩元AI基金和5000亿韩元半导体专项**

据韩联社4月2日首尔报道，韩国首尔市政府2日宣布，将投2000亿韩元打造“AI城市首尔”，以提高市民生活便利性和公职人员工作效率。同时韩国政府宣布，将半导体产业扶持资金规模从26万亿韩元提升至33万亿韩元，其中财政直接投入规模增加2.5万亿韩元，达到4.2万亿韩元，并特别设立5000亿韩元专项基金，用于支持半导体尖端材料、零部件及设备领域的中小企业，单家企业最高可获得200亿韩元资助。

(二) 经济指数

● 2025 年 4 月全球制造业 PMI 分析：贸易担忧与出口订单疲软拖累增长

2025 年 4 月，全球制造业 PMI 降至 49.8，较上月回落 0.5 个百分点，为四个月来首次跌破荣枯线。然而，整体放缓的背后，各主要地区表现显著分化。

印度表现亮眼，PMI 达 58.2，新出口订单大幅增长推动制造业持续强劲扩张。相比之下，中国制造业活动陷入收缩，PMI 回落至 49.0，较 3 月明显下滑。日本（48.7）和韩国（47.5）制造业持续萎缩，反映两国制造业仍面临挑战。欧元区 PMI 为 49.0，同样处于收缩区间。美国 PMI 微升至 50.2，虽仍高于荣枯线，但扩张动能疲弱。

此次全球制造业放缓主要受贸易壁垒和保护主义升温的影响，企业订单、供应链和商业信心均受冲击，全球商业乐观情绪跌至两年半低点。尤为值得关注的是，全球新出口订单创下 2023 年 8 月以来最大跌幅。尽管增长势头减弱，通胀压力依然存在，投入成本与产出价格持续攀升，可能与贸易不确定性和供应短缺有关。

2025 年 4 月数据表明，全球制造业呈现“区域分化与增长阻力并存”的复杂格局，需密切关注后续演变，以便为市场研究与战略规划提供参考。

全球各地区制造业 PMI

时间	全球	中国	日本	韩国	印度	美国	欧元区
2024-04	50.30	50.40	49.60	49.40	58.80	49.20	45.70
2024-05	50.90	49.50	50.40	51.60	57.50	48.70	47.30
2024-06	49.50	49.50	50.00	52.00	58.30	51.70	45.60
2024-07	49.80	49.40	49.10	51.40	58.10	46.80	45.80
2024-08	48.90	49.10	49.80	51.90	57.50	47.20	45.60
2024-09	48.80	49.80	49.70	48.30	56.50	47.20	45.00
2024-10	48.80	50.10	49.80	48.30	57.50	46.50	46.00
2024-11	50.00	50.30	49.00	50.60	56.50	48.40	45.20
2024-12	49.60	50.10	49.60	49.00	56.40	49.20	45.10
2025-1	50.10	49.10	48.70	50.30	57.70	50.90	46.60
2025-2	50.60	50.20	49.00	49.90	56.30	50.30	47.60
2025-3	50.30	50.50	48.40	49.10	58.10	49.00	48.60
2025-4	49.80	49.00	48.70	47.50	58.20	49.70	49.00

数据来源：Wind

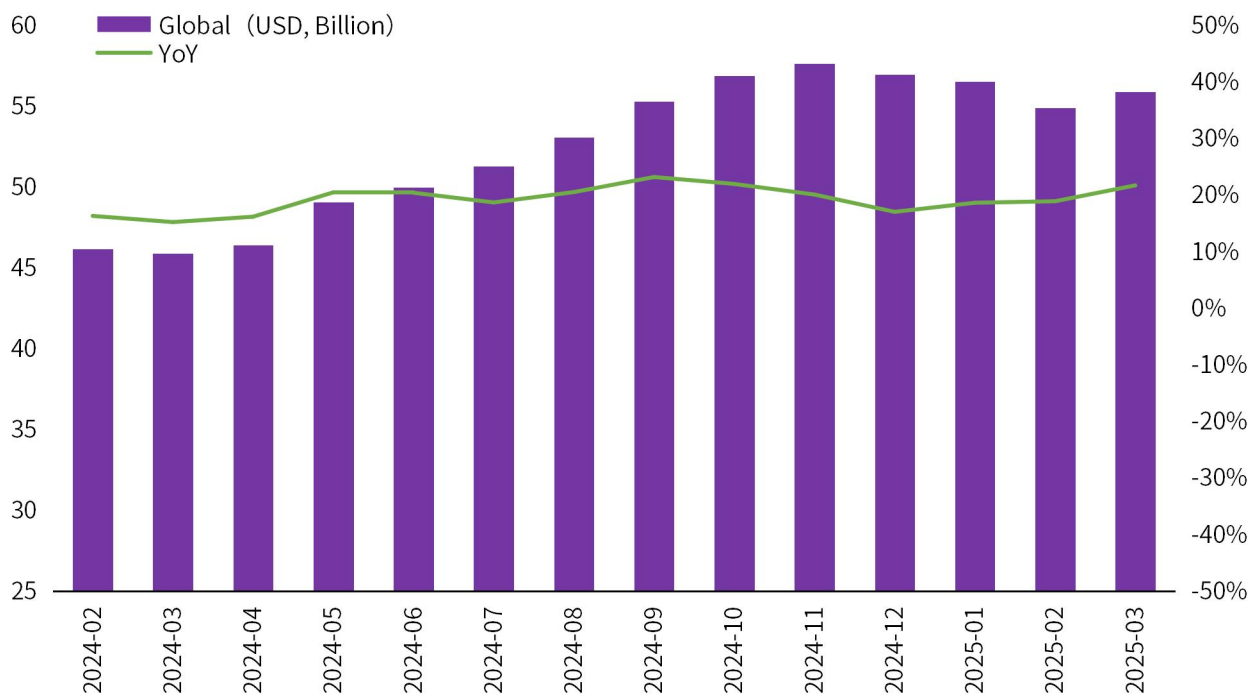
● 2025 年 Q1 全球半导体销售额同比增长 18.8%；3 月销售额环比增长 1.8%延续上行趋势

半导体行业协会 (SIA) 发布数据显示, 2025 年第一季度全球半导体销售额达到 1677 亿美元, 较 2024 年同期增长 18.8%, 但环比 2024 年第四季度下降 2.8%。2025 年 3 月全球销售额为 559 亿美元, 较 2 月的 549 亿美元环比增长 1.8%。月度销售数据由世界半导体贸易统计组织 (WSTS) 编制, 采用三个月移动平均值。SIA 会员企业覆盖美国半导体行业 99% 的营收以及近三分之二的海外芯片企业。

全球半导体需求持续强劲, 第一季度销售额显著超越 2024 年同期水平。此外, 在美洲地区约 45% 同比增幅的推动下, 半导体销售额已连续 11 个月实现超 17% 的同比增长。

从区域表现来看, 2025 年 3 月半导体销售额同比呈现分化态势: 美洲 (+45.3%)、亚太/其他地区 (+15.4%)、中国 (+7.6%) 及日本 (+5.8%) 实现增长, 欧洲 (-2.0%) 则出现下滑。环比数据方面, 欧洲 (+5.7%)、亚太/其他地区 (+3.6%) 和中国 (+2.4%) 保持增长, 而美洲 (-0.4%) 与日本 (-0.4%) 略有回落。

全球半导体销售额 (十亿美元)



数据来源: SIA

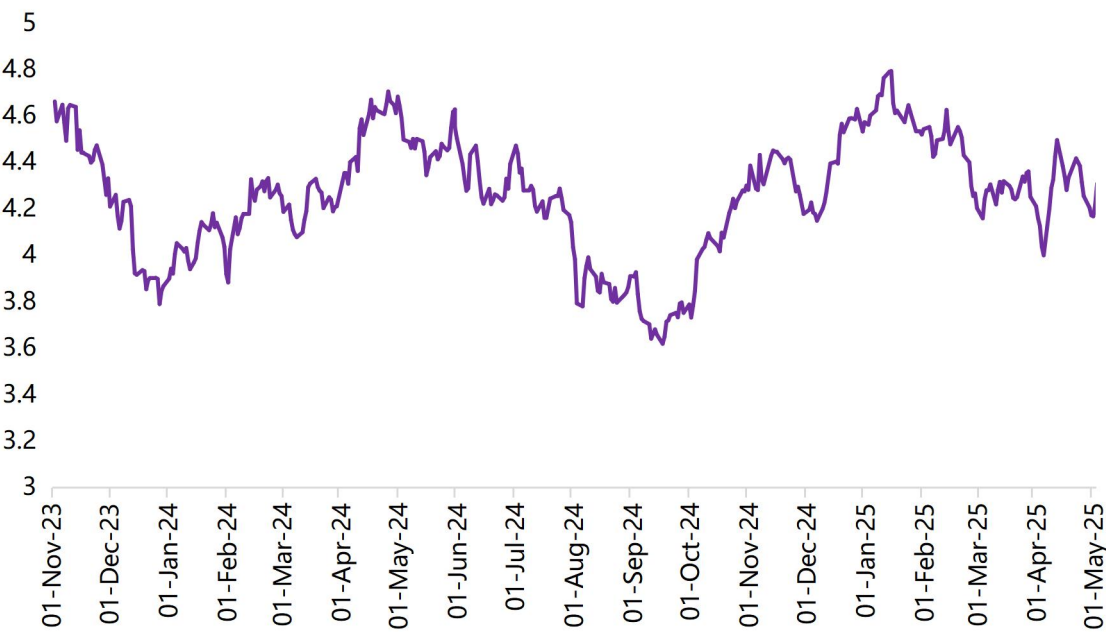
● 美国 10 年期国债收益率 5 月上行通胀担忧与关税不确定性交织

2025 年 5 月，美国 10 年期国债收益率呈现上行趋势，当前交投于 4.481%附近，较 4 月平均水平的 4.28%有所攀升。这一走势出现在 4 月消费者价格指数（CPI）数据公布之后——该数据显示同比涨幅为 2.3%，略低于预期的 2.4%。然而，收益率的下行反应有限，表明市场仍持谨慎态度，尤其关注前总统特朗普关税政策的潜在通胀效应以及核心通胀的粘性（符合预期维持在 2.8%）。正如美联储前副主席罗杰·弗格森所强调，这一态势强化了市场对美联储降息可能性的"观望立场"。

2025 年 5 月最新达成的中美贸易协定为市场增添了复杂性。根据协议，双方将在 90 天内暂停大部分关税措施，将"对等"关税从 125%降至 10%。尽管这一进展可能缓解短期关税压力，并适度缓和双边贸易相关的通胀担忧，但 Pepperstone 分析师迈克尔·布朗指出，政策决策的"反复无常特性"可能削弱机构信誉并侵蚀资产价值。华侨银行经济学家瓦苏·梅农进一步警告，特朗普提出的全面 10%通用关税及其他政策转向，虽不会立即引发经济衰退，但可能对美国经济及企业部门造成负面影响。

全面关税威胁与贸易政策的不确定性持续构成重大风险，可能导致供应链中断和成本上升，进而影响半导体行业的盈利能力和长期投资前景。后续建议：需在利率波动与贸易政策动态变化的环境中审慎布局，充分认识这些因素对公司业绩和市场情绪可能产生的双向影响。

美国 10 年期国债利率(%)

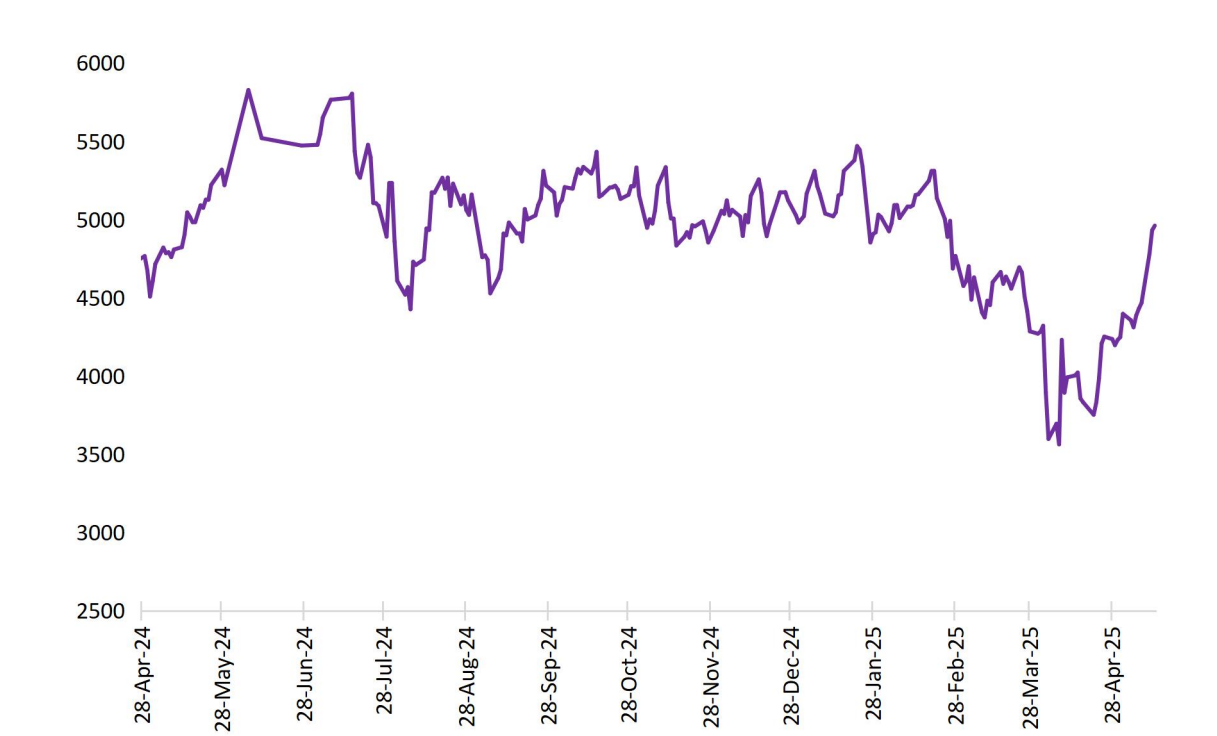


数据来源: Investing

● 费城联储调查报告：5 月商业景气指数小幅回升但仍处于收缩区间

费城联邦储备银行 5 月商业前景调查显示，地区商业景气出现温和反弹，整体商业状况指数从 4 月的-26.4 回升至-5.0。尽管有所改善，但该读数仍表明第三联邦储备区商业活动处于萎缩状态。值得注意的是，ActionEconomics 预测调查此前预期涨幅更为有限，此次回升幅度超出市场预期。具体来看，报告业务活动下降的企业比例从 4 月的 39%降至 23%，而报告活动增加的企业比例从 13%上升至 19%。大多数企业（58%）仍表示业务活动维持不变。

费城半导体指数(SOX)



数据来源：MacroMicro

二、半导体产业动态

半导体产业动态概览			
维度	厂商	经营动态	解读
短期影响	英伟达 NVIDIA	英伟达推动本土 AI 算力部署，Blackwell 芯片美产加速	英伟达加速在美国本土生产 Blackwell 芯片，以增强供应链韧性，但高昂的制造成本可能对其利润率构成压力
	美光 Micron SK 海力士 SK Hynix 三星 Samsung	存储价格反弹，DDR4 退场与 HBM/LPDDR5X 加速切换	AI 服务器与 AIPC 需求驱动存储市场复苏，头部厂商借技术迭代巩固垄断地位
	圣邦微电子 SG Micro	一季度营收同比增长 8.3%，达 7.9 亿元	模拟芯片需求稳定增长，业绩表现稳健，市场认可度提升
中期影响	英特尔 Intel	英特尔委托台积电代工 2nm，IDM 战略面临现实调整	英特尔先进制程进展滞后，被迫依赖台积电技术，反映美国本土先进制造能力不足
	意法半导体 STMicroelectronics	推出新一代车规级 MCU，强化汽车电子市场布局	面向电动化和智能化趋势，提升在汽车电子领域的市场份额
	安世半导体 Nexperia	推出 1200V SiC MOSFET，拓展汽车与工业应用	满足高压应用需求，提升产品竞争力，推动电动汽车与工业设备升级
	兆易创新 GigaDevice	与纳微半导体达成战略合作，打造高效数字电源解决方案	结合 MCU 与 GaN 技术，布局 AI 数据中心与新能源市场，推动电源管理创新
长期影响	高通 Qualcomm	加大自研 AI 芯片投入，布局边缘计算和智能终端市场	自研 AI 芯片战略增强产品竞争力，推动边缘计算和智能终端的发展
	三星 Samsung	加速 HBM4 研发，布局 AI 高带宽内存市场	HBM4 技术将成为 AI 芯片性能提升的关键，三星积极布局以保持技术领先
	士兰微 Silan Micro	中国 28nm 以上成熟制程 IDM 扩产	士兰微加速扩产成熟制程产能，强化 IDM 模式，提升国产替代能力

（一）短期影响

- **英伟达推动本土 AI 算力部署，Blackwell 芯片美产加速**

英伟达依托 Blackwell 芯片推动的新一代 AI 服务器计划，标志其正尝试从高度依赖亚洲制造向多元布局过渡。尽管与台积电美国厂的合作可缓解地缘政治风险，但美国本土制造单位成本高、良率爬坡慢的问题仍将对英伟达的整体毛利构成压力。此外，从战略角度看，这种调整体现出 AI 芯片巨头在产业链安全性和长期供应保障上的优先级提升。

- **存储价格反弹，DDR4 退场与 HBM/LPDDR5X 加速切换**

2025 年第二季度以来，DRAM 与 NAND Flash 价格显著反弹，环比涨幅普遍达到 8%-20%。三大存储厂商同步缩减 DDR4 传统产能，转而加码高带宽存储（HBM）与新一代低功耗 LPDDR5X，说明市场需求正在迅速向 AI 服务器、智能终端与 AIPC 等前沿领域转移。随着先进封装技术的普及，存储芯片将与 SoC 深度融合，形成新的技术壁垒，加剧头部企业的市场垄断格局。

- **圣邦微电子一季度营收同比增长 8.3%，达 7.9 亿元**

圣邦微电子公布 2025 年第一季度财报，营收同比增长 8.3%，达到 7.9 亿元人民币。业绩增长主要得益于模拟芯片在工业控制、新能源和汽车电子等领域的需求稳定增长。公司持续优化产品结构，提升研发投入，进一步巩固了其在高端模拟芯片市场的领先地位。

（二）中期影响

- **英特尔委托台积电代工 2nm，IDM 战略面临现实调整**

尽管英特尔持续推进 IDM 2.0 战略，但其在 2nm 及以下先进制程方面的进展仍不及预期。此次下单台积电用于制造 Nova Lake 平台的计算模块，说明英特尔在高性能产品上不得不依赖外部 Foundry 以保障产品进度。此举突显美国本土在 EUV 设备、先进材料以及工艺集成方面的产业链短板，也再次验证台积电在亚纳米级制程领域的技术领导地位。

- **意法半导体推出新一代车规级 MCU，强化汽车电子市场布局**

意法半导体近期发布了新一代车规级微控制器（MCU），旨在满足电动化和智能化趋势下汽车电子市场的需求。新产品在性能、安全性和能效方面均有显著提升，支持更复杂的驾驶辅助系统和车载信息娱乐系统。通过强化在汽车电子领域的产品线，意法半导体有望提升其在该市场的份额，进一步巩固其在车规级半导体领域的领导地位。

- **安世半导体推出 1200V SiC MOSFET，拓展汽车与工业应用**

安世半导体近期推出了 1200V SiC MOSFET，采用先进的表面贴装封装技术，旨在满足电动汽车和工业设备对高压、高效能功率器件的需求。该产品的发布标志着 Nexperia 在宽禁带半导体领域的技术进步，有助于其拓展在高增长市场的应用范围，提升产品竞争力。

- **兆易创新与纳微半导体达成战略合作，打造高效数字电源解决方案**

兆易创新与纳微半导体达成战略合作，结合兆易创新的高性能 MCU 产品与纳微的高频、高速、高集成度的氮化镓技术，共同打造智能、高效、高功率密度的数字电源产品。该合作旨在加速在 AI 数据中心、光伏逆变器、储能、充电桩和电动汽车等领域的商业化布局，推动电源管理方案的创新升级。

（三）长期影响

- **高通加大自研 AI 芯片投入，布局边缘计算和智能终端市场**

高通宣布加大对自研 AI 芯片的投入，旨在提升其在边缘计算和智能终端市场的竞争力。新一代 AI 芯片将集成更强大的神经网络处理单元（NPU），支持更高效的本地 AI 推理，降低对云端的依赖。此举不仅增强了高通产品的差异化竞争力，也有助于推动边缘 AI 应用的发展，满足智能手机、可穿戴设备和物联网设备对本地 AI 处理能力日益增长的需求。

- **三星加速 HBM4 研发，布局 AI 高带宽内存市场**

三星电子正在加速下一代高带宽内存（HBM4）的研发，以满足 AI 芯片对内存带宽和容量日益增长的需求。HBM4 预计将在带宽、能效和容量方面实现显著提升，成为 AI 芯片性能提升的关键。三星的积极布局有望在未来的 AI 高带宽内存市场中保持技术领先地位，进一步巩固其在全球存储器市场的领导地位。

- **士兰微中国 28nm 以上成熟制程 IDM 扩产**

士兰微作为中国领先的功率半导体 IDM 企业，近年来持续加大在 28nm 以上成熟制程领域的投资与扩产。公司在厦门建设的 8 英寸碳化硅(SiC)功率器件产线已于 2025 年初封顶，预计 2026 年一季度投产，最终形成年产 42 万片的产能。此外，士兰微在杭州的 12 英寸特色工艺晶圆生产线也在稳步推进，规划月产能达 8 万片。这些扩产项目将进一步提升士兰微在功率半导体领域的竞争力，满足新能源汽车、工业控制、通信等高增长市场的需求。

三、终端市场动态

终端市场动态概览			
类别	版块	厂商	4-5 月市场动态
人工智能	AI 芯片	英伟达 NVIDIA	英伟达与沙特 HUMAIN 合作建设 AI 工厂， 将部署 1.8 万块 GPU 构建 500 兆瓦算力中心
	云计算与大数据	DeepSeek	发布 Prover-V2 模型，参数量达 6710 亿
新能源	光伏、储能	宁德时代 CATL	宁德时代发布全球首款 9MWh 储能系统
	新能源汽车	特斯拉 TESLA	Q1 交付量跌至三年来最低水平
消费电子	智能手机	华为 HUAWEI	华为 Pura80 系列将搭载麒麟 9020 芯片和定制 RYYB 传感器
	无人机	优必选 UBTECH	优必选与创耀科技合作开发人形机器人芯片解决方案，瞄准服务机器人自动化应用场景
工业电子	工业自动化 与控制	霍尼韦尔 Honeywell	预计今年销售额为 396-405 亿美元
汽车电子	车载操作智能系统	德赛西威 DesaySV	德国工厂已生产运营，西班牙工厂预计年底竣工
通信电子	通信网络、光纤	中兴通讯 ZTE	2025Q1 智算服务器订货占比超 60%
医疗电子	医疗影像设备	强生 J&J	加码手术机器人、AI 医疗等高附加值领域； 预计下半年营收增长会更高

(一) 人工智能

● 英伟达与沙特 HUMAIN 合作建设 AI 工厂

5 月 13 日，英伟达 CEO 黄仁勋宣布，已与沙特新成立的人工智能公司 HUMAIN 达成合作，将部署 1.8 万枚英伟达芯片建设一个规模达 500 兆瓦的数据中心。该合作为期五年，并在沙特首都利雅得举行的美沙投资论坛上宣布。HUMAIN 由沙特主权财富基金出资成立，致力于构建阿拉伯语大语言模型以及 AI 基础设施，包括数据中心建设。

- **DeepSeek 发布 Prover-V2 模型**

4月30日,DeepSeek在HuggingFace平台发布Prover-V2模型,参数量达6710亿,是前代版本的近百倍,刷新开源数学推理模型体量上限。该模型专注于形式化数学证明任务,适用于自动定理验证等场景,为人工智能应用提供更多可能性。

(二) 新能源

- **宁德时代发布全球首款 9MWh 储能系统**

宁德时代在新能源储能领域取得重大突破,发布了全球首款9MWh储能系统,该系统具有更高的能量密度和效率,能够有效提升储能性能,为大规模储能应用提供更优质的解决方案,助力新能源的存储与利用。

- **特斯拉 25 年 Q1 交付量跌至三年来最低水平**

特斯拉2025年第一季度汽车销售下降13%,为2022年第二季度以来的最低季度水平,下降原因主要受制于主要车型改款以及首席执行官埃隆·马斯克引发的国际反感情绪,截至4月底收盘特斯拉股价已暴跌44%。

(三) 消费电子

- **华为 Pura80 系列将搭载麒麟 9020 芯片和定制 RYYB 传感器**

华为即将推出的Pura80系列手机,将搭载麒麟9020芯片以及定制的RYYB传感器,并全系搭载创新双层OLED屏幕技术,这将显著提升手机的运算处理能力和功耗控制表现,华为Pura80系列预计将在今年6月正式亮相。

- **优必选与创耀科技合作开发人形机器人芯片解决方案**

全球人形机器人头部企业优必选与通信芯片企业创耀科技达成战略合作,联合开发针对人形机器人的芯片解决方案,旨在提升机器人自动化应用场景,推动服务机器人技术的发展和拓展。

(四) 工业电子

- **霍尼韦尔预计今年销售额为 396-405 亿美元**

4月29日,霍尼韦尔公布了2025年第一季度财报,并更新了全年业绩指引,预计全年销售额将在396亿至405亿美元之间。公司计划在2026年下半年完成对先进

材料业务的分拆以及自动化与航空航天业务的分离，预计形成三家行业领先的上市公司。

(五) 汽车电子

- **德赛西威德国工厂已生产运营，西班牙工厂预计年底竣工**

惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司的德国工厂已正式投入生产运营，同时其西班牙工厂也在建设中，预计年底竣工。这标志着中国汽车电子企业在欧洲市场的进一步拓展，有助于提升在全球汽车电子市场的供应能力和竞争力。

(六) 通信电子

- **中兴通讯 2025Q1 智算服务器订货占比超 60%**

中兴通讯执行副总裁、首席运营官谢峻石在中兴中国生态合作伙伴大会称，一季度中兴智算服务器订货占比超 60%。目前中兴通讯已将互联网市场定位为战略市场，希望扩大与字节、阿里、腾讯等头部公司的合作规模，拼抢互联网企业智算订单。

(七) 医疗电子

- **强生加码手术机器人、AI 医疗等高附加值领域**

根据强生 (Johnson&Johnson) 2024 年第四季度及全年财报，其医疗板块全年销售额达 318.57 亿美元，同比增长 4.8%；2025 年将在在手术机器人、AI 医疗领域的持续加码，作为其未来增长的关键布局。

四、重点产品行情

(一) 存储芯片

● 五大 NAND 原厂同步减产，部分产品价格上涨

1) 市场竞争：据行业研究机构 Counterpoint 发布的 2025 年第一季度 DRAM 内存市场份额报告显示，SK 海力士首度超越三星电子，夺得该季度市场占比第一。SK 海力士、三星电子和美光科技分别占据了 36%、34%和 25%的市场份额，其余厂商则占据了剩余的 5%。

2) 供需关系

需求端增长：全球 IT 设备制造商为应对美国关税风险，急于增加芯片库存，推动采购需求。同时，据 TrendForce 集邦咨询的最新调查，强劲的 AI 应用需求将持续带动企业级 SSD 年需求量增长 30%，终端设备存储配置也将大幅提升。

供给端减产：近期，五大 NAND 原厂同步减产，供给面收缩。三星、美光等原厂 NAND 减产 15%-25%。SK 海力士等厂商也在进行产能结构性调整，减少对传统制程产品如 DDR3 和 DDR4 的生产，这将导致部分存储芯片供应紧张。

1) 价格方面：DRAM 的平均销售价格 (ASP) 在经历了五个月的低迷之后，于 4 月份开始攀升。据市场研究公司 DRAMeXchange 的数据，标准 PC DRAM (DDR4 8Gb 1Gx8) 的固定合同价格环比上涨 22.2%，达到 1.65 美元。

各厂商存储芯片交期情况

厂商	产品系列	交期 (周)	交期趋势
SK 海力士 SK Hynix	NAND FLASH	6-10	交期缩短
	eMMC	8-12	交期稳定
英飞凌 INFINEON	SRAM	12-52	交期稳定
	NOR FLASH	12-26	交期稳定
兆易创新 GigaDevice	NOR FLASH	8-12	交期稳定
	NAND FLASH	6-10	交期稳定
三星 Samsung	PC DRAM	32-54	交期稳定
	SSD	30-54	交期稳定

信息来源：富昌电子、网络公开资料整理

(二) GPU

● 英伟达 GPU 市场份额下滑，AMD、英特尔份额上涨

1) 市场行情：2025 年 4 月 5 日，全球硬件评测工具 CPU-Z 发布最新显卡榜单，英伟达的 RTX 3060 以 3.7% 的占有率蝉联榜首，连续五年稳居 Steam 显卡使用率冠军，但英伟达 GPU 市场份额却从 74.3% 降至 67.9%，创历史新低。AMD 市场份额从 16.6% 增长至 31.1%，RX 7900 系列高端卡拉动品牌溢价；英特尔则凭借 Arc 系列 27% 的同比增长，GPU 市场份额提升至 0.7%。

2) 供需关系

需求端：DeepSeek 的 Prover-V2 大模型和 GPT-5 级大模型在多领域规模化落地，AI 技术的快速发展持续推动 GPU 需求增长。智能汽车、工业互联网等场景对边缘计算的需求增加，使得全球 AI 算力需求爆发式增长，GPU 市场需求水涨船高。

供应端：英伟达部分高端显卡供应受限，如 RTX5090D 停售、H20 被纳入出口管制清单。高通近期宣布将重返数据中心市场，以深度对接英伟达的人工智能 AI 芯片。

3) 价格方面：据台湾《电子时报》5 月 12 日报道，英伟达近期对旗下几乎所有产品的官方价格进行了调整，以应对关税和制造成本上升带来的影响。其中，游戏显卡价格平均上涨 5% 至 10%，而人工智能（AI）专用 GPU 价格涨幅则高达 15%。RTX5090 被评为 PC 显卡中最高规格，较年初上涨了 25% 以上。

各厂商 GPU 市场趋势

厂商	订单趋势	价格趋势
英伟达 NVIDIA	上升	上升
超威半导体 AMD	上升	稳定
英特尔 Intel	稳定	稳定
高通 Qualcomm	稳定	稳定

信息来源：网络公开资料整理

(三) MCU

● MCU 车规市场规模可观，国产替代化加速

1) 市场格局：2025 年 4 月，全球车规级 RISC-V MCU 市场应用前景调研报告发布，据 Yole Group 预测，2028 年全球 MCU 市场规模将达到 320 亿美元，其中汽车与工业领域将贡献 60%以上的增量。

2) 供需关系：

需求端：据调研报告数据显示，2025 年新能源汽车智能化升级将推动高端车用 MCU 市场增长超 15%，单辆智能汽车 MCU 用量可达传统燃油车的 4 倍；

供应端：恩智浦、意法半导体、德州仪器 2025 年一季度业绩未达预期，将进一步影响其对市场的供应决策。国内企业积极推进国产化替代，中微半导体车规 MCU 订单持续放量，2025 年一季报显示主营收入 2.06 亿元，同比上升 0.52%。随着国内技术提升，在一些传统高阶 MCU 芯片领域，国产占比未来几年有望持续提升。

3) 价格方面：2025 年 4 月，车规 MCU 价格整体保持稳定，但由于市场需求增长和供应端调整，部分型号价格有所上涨。例如，NXP 车规 MCU 在 4 月需求较上个月增长了近 40%，但总体来看需求依旧比较疲软。汽车料的需求上涨明显。通用料方面，市场需求比较平稳。

各厂商 MCU 交期情况

厂商	产品系列	交期（周）	交期趋势
意法半导体 ST	8 位 MCU	10-24	交期稳定
	32 位 MCU	13-16	交期缩短
	汽车 MUC	40-52	交期稳定
英飞凌 INFINEON	8 位 MCU	10-26	交期稳定
	32 位 MCU	10-26	交期稳定
	汽车 MUC	32-54	交期稳定
恩智浦 NXP	8 位 MCU	13-39	交期稳定
	32 位 MCU	13-39	基本稳定
	汽车 MUC	18-52	交期稳定
	32 位 MPU	13-39	交期稳定
微芯 MICROCHIP	8 位 MCU	4-12	交期稳定
	32 位 MCU	4-18	交期稳定

信息来源：富昌电子、网络公开资料整理

信息来源

- [1] 美方滥用出口管制限制使用华为“昇腾”芯片（环球时报-环球网）
- [2] 中美日内瓦经贸会谈联合声明（央视新闻）
- [3] 欧盟《芯片法案 2.0》战略升级！（全球半导体观察）
- [4] 《市场准入负面清单（2025 年版）》（国家发改委）
- [5] 《关于半导体产品“原产地”认定规则的紧急通知》（半导体行业协会）
- [6] 韩国政府大幅加码半导体产业扶持政策，应对美国关税威胁（人民网韩国频道）
- [7] www.honeywell.com.cn/news-events/newsroom/news/2025/04
- [8] Tesla:deliveriesinthefirstquarterdroppedtoanearlythree-yearlow
- [9] m.jrj.com.cn/rss/yidianzixun/2025/5/14
- [10] 解读|由强生财报看医疗器械行业发展和启示,2025
- [11] 中兴通讯 2025 年首季营收同比增长 7.8%,2025
- [12] 英伟达推动 AI 服务器本土部署，Blackwell 芯片美产加速，路透社，2025
- [13] DRAM 与 NAND 价格回升，存储厂商转向 HBM 与 LPDDR5X, TrendForce
- [14] 英特尔向台积电下单 2nm 制程，Nova Lake 平台计算模块代工启动，彭博社，
- [15] Nexperia 推出 1200V SiC MOSFET，拓展汽车与工业应用，半导体投资联盟
- [16] 兆易创新与纳微半导体达成战略合作，打造高效数字电源解决方案，集微网
- [17] 高通加大自研 AI 芯片投入，布局边缘计算和智能终端市场，路透社，2025
- [18] 三星加速 HBM4 研发，布局 AI 高带宽内存市场，集微网，2025
- [19] 士兰微中国 28nm 以上成熟制程 IDM 扩产，半导体投资联盟，2025
- [20] TrendForce: EnterpriseSSD 价格和出货量同步上升
- [21] CounterpointResearch《内存市场追踪》2025Q1
- [22] 海力士 DRAM 颗粒价格上调超 10%，2025
- [23] 2025 版：全球车规级 RISC-V MCU 市场应用前景调研报告
- [24] RTX 3060 霸榜五年！2025 显卡市场大洗牌，2025
- [25] 台湾《电子时报》：NVIDIA 将 GPU 价格上调 25%

免责声明

安芯易电子商务（深圳）有限公司(下称“安芯易公司”)所发布的月度报告由安芯易公司市场部基于现已公开的资料、信息、研究报告等进行整理编制而成。

本报告所载的资料、意见及推测仅反映安芯易公司在报告发布当期的判断、观点，仅供学习参考之用，不构成对所述产品的出价、征价、要约或要约邀请，不构成任何合同或承诺的基础，不构成买卖任何投资工具或者达成任何交易的推荐，亦不构成任何投资、采购及其他应用建议和指导，对任何因直接或间接使用本报告涉及的信息和内容或者据此进行交易、投资所造成的一切后果或损失，安芯易公司不承担任何法律责任。因此，读者在阅读本报告时应保持警惕，并进行独立的判断和分析。

安芯易公司对本报告中所引用的资料、研究报告所涉及的或从第三方媒体获得的信息及数据的真实性、准确性、完整性和及时性不作任何明示或默示的保证。所发布的信息、观点以及数据有可能因发布日之后的情势或其他因素的变更而不再准确或失效，但安芯易公司不承担更新不准确或过时的信息、观点以及数据的义务，在对相关信息进行变更或更新时亦不会另行通知。

该报告版权归安芯易公司及相关内容提供方所有，未经授权，任何人不得以任何方式转载、修改、翻版、分发、复制、发表。

安芯易电子商务（深圳）有限公司

2025 年 5 月



安芯易隶属于Ample Solutions集团,成立于2008年,在全球拥有8个办公室,专注于为全球电子制造业客户提供元器件全球采购及供应链服务。我们始终秉持“专注、专业、坚韧、谦卑”的核心价值观,为客户提供卓越服务,助力客户成功。

我们拥有100+资深采购专家,并与来自全球的10000+供应商建立合作,致力于以更快的速度,更低的成本,为客户解决元器件供应链问题。

在深圳和香港,我们建立了两个高标准品质控制中心,严格遵循国际品质控制体系。从供应商管理到品质检测,全方位地防范风险,确保客户的元器件供应链安全和稳定。



洞察行情 精准决策

